

股票代碼：3580

友威科技 營運簡報

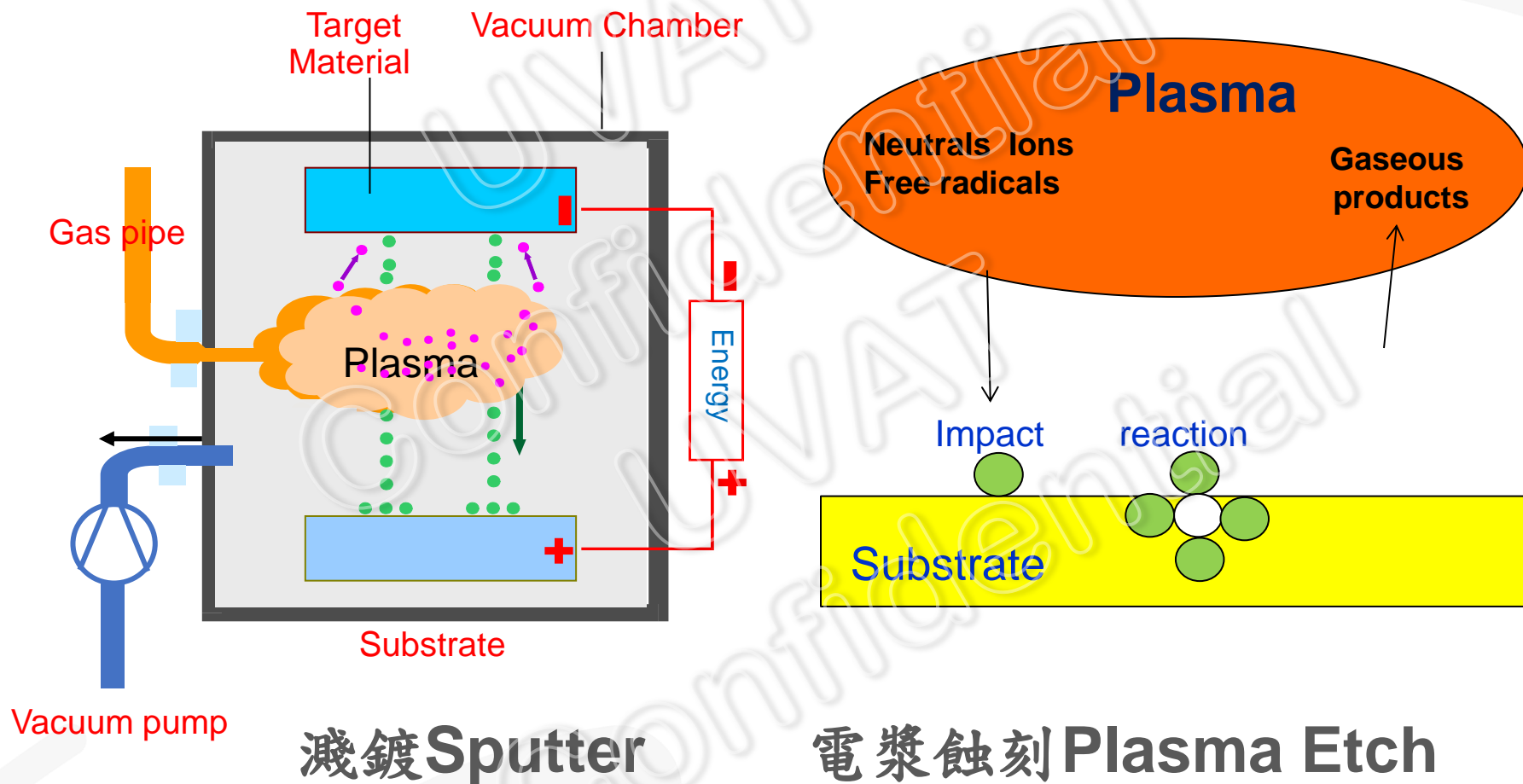
Date：112/03/16

投資人關係聯絡方式：

E-mail：theresachen@uvat.com

UVAT
Vacuum Ecosystems

乾式(Dry)製程的解決方案



濺鍍 Sputter

電漿蝕刻 Plasma Etch

友威的核心

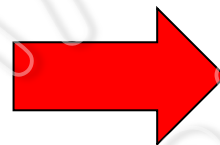
乾式
真空製程

綠色製程
環保製程

濺鍍
Sputtering

蝕刻
Etching

薄型化
薄膜化



關於友威

成立時間	2002/11/04
董事長暨總經理	李原吉
資本額	新台幣3億9,470萬
員工	台灣：120人 中國：約300人
服務項目	真空濺鍍設備 蝕刻設備 半導體設備及相關耗材 鍍膜代工 光學鍍膜 薄膜元件



- ❖ 2007年股票公開發行
- ❖ 2008年Forbes亞太200大最佳中小企業
- ❖ 2010年7月9日股票上櫃(友威科3580)

里程碑

2002-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2022



Sputter

Etch

Semi

2021年台灣精品獎

UVAT

產業類別：生產力&能源精品

產品型號：鈦銅種子層濺鍍機

連續式真空濺鍍機

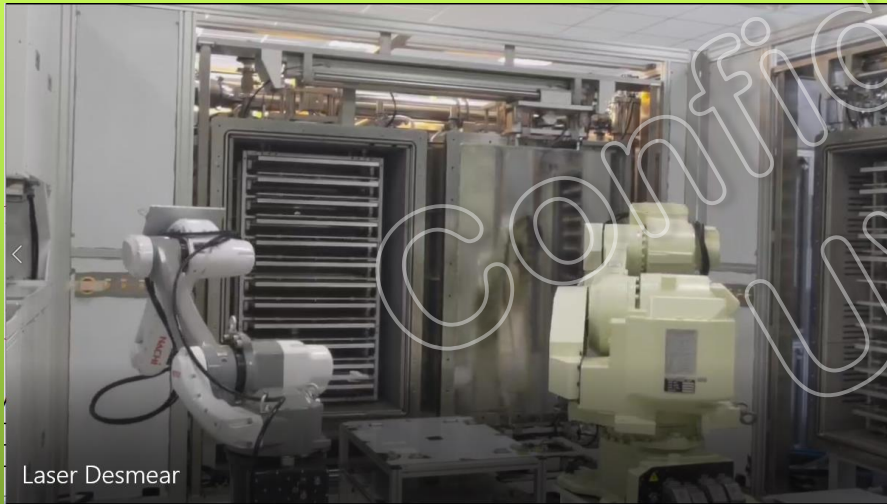


台灣精品 2021
TAIWAN EXCELLENCE



蝕刻 Dry Etch

- Panel level plasma treatment



- High aspect ratio plasma descum



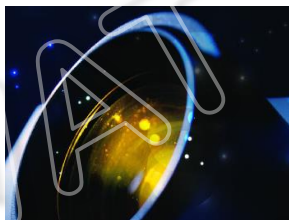
- Fine pitch metal etch



主要市場



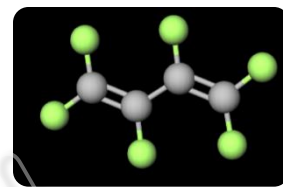
汽車



光學
產業



石英產業



消費性
電子



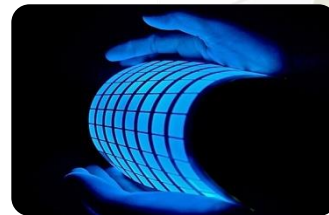
被動元件

IC 載板
電路板

半導體封裝

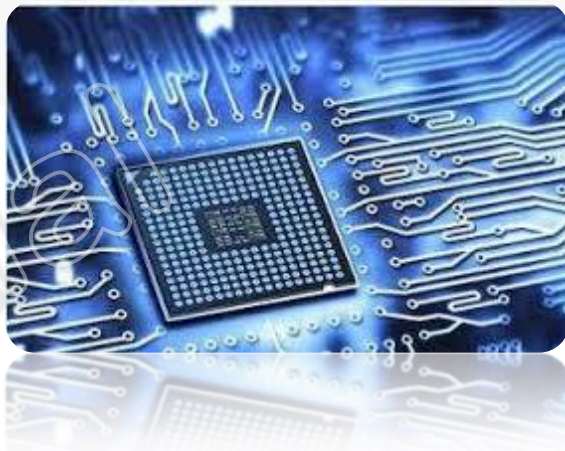


晶片內埋



未來主要市場

Semi半導體
ABF載板

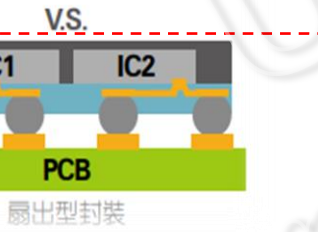
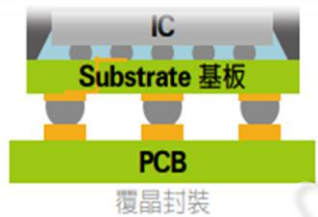


消費性電子
光學鍍膜

元件

- 被動元件
- 石英元件
- 散熱元件
- 光學元件
- HUD元件

封裝應用的發展_FOPLP

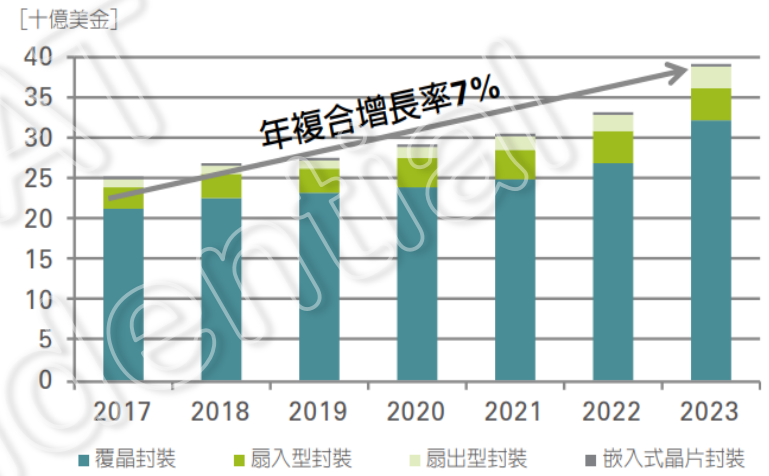
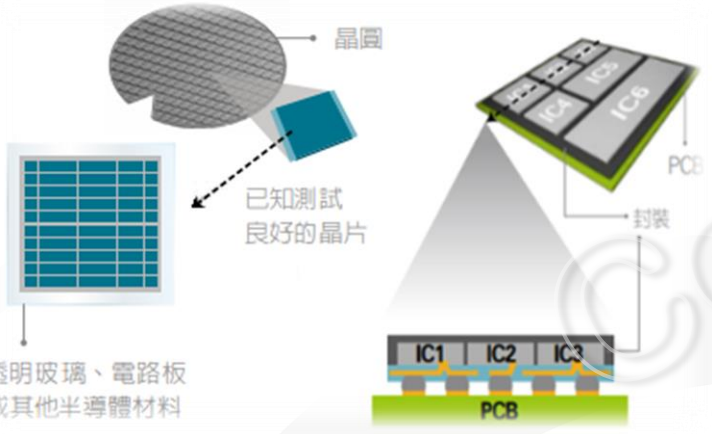


2021~ 年由於半導體缺貨，且封測代工產業也因中高階載板供應不足下，導致原有應用於先進封裝如 BGA、Flip Chip 與 SiP 等交貨進度受影響。

驅使無載板、可一次性大面積封裝且有效降低製造成本的面板級封裝 FOPLP 應用備受矚目。

率良提升

多晶片整合



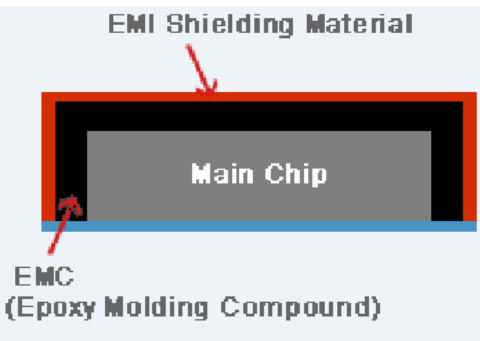
優勢：

- 挑出良好IC 進行封裝，提升良率
- 多晶片異質晶片整合
- 縮小封裝體積
- 大面積封裝降低成本

IC封裝產業應用

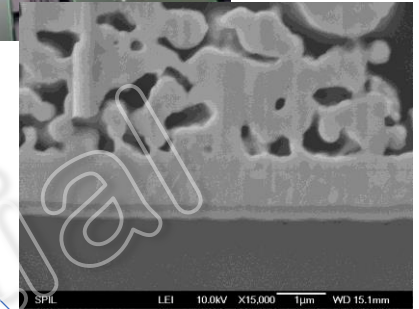
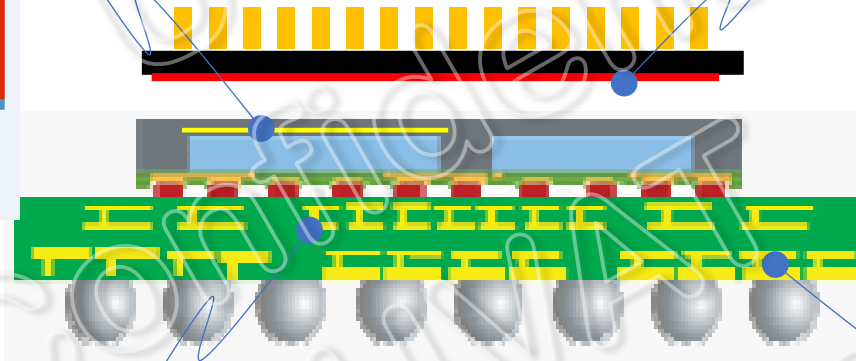
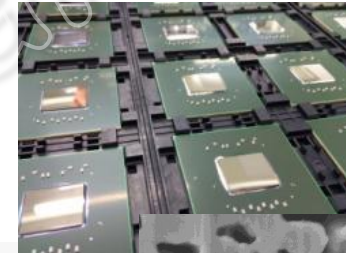
SIP EMI

SUS/Cu/SUS



Thermal Dissipation

Ti/NiV/Ag, Ti/NiV/Au



Plasma Etcher

- Ti/Cu Seed Layer Dry Etch
- Plasma Descum
- Plasma Pre-treatment

Seeding Sputter

Ti/Cu



消費性電子產業應用

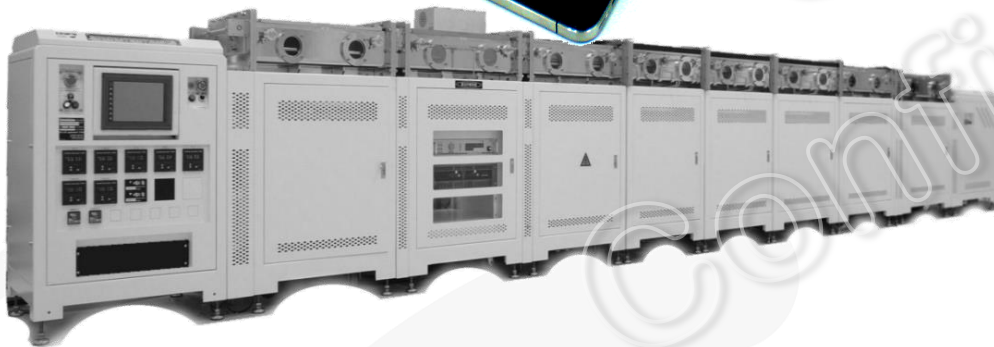
3C 電子產品應用

SDC 外觀裝飾性鍍膜

手機外殼、按鍵、面板
塑膠金屬化裝飾

NCVM 非導電金屬鍍膜

無線訊號發射外觀裝飾
穿透射頻薄膜



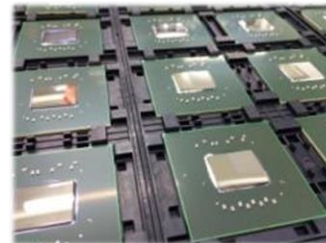
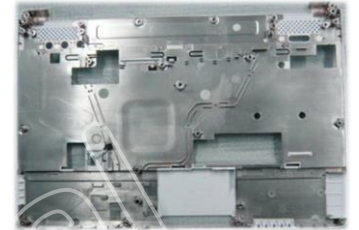
EMI 電磁波屏蔽應用

手機外殼 EMI 鍍膜

筆記型電腦外殼 EMI 鍍膜

CMOS/CCD Holder EMI 鍍膜

System In Package EMI 鍍膜



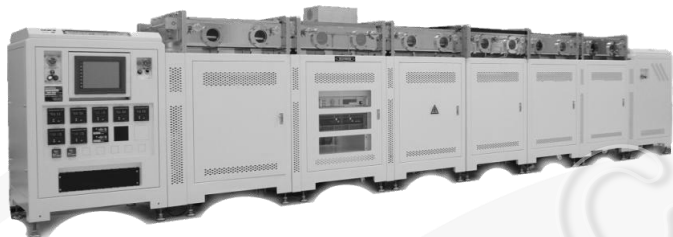
汽車產業應用



銘鏡、藍鏡、
光學半透鏡



綠色環保製程、
節能無污染



2019~2022簡明損益表

年度	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
營業收入	750,362	100%	538,325	100%	773,161	100%	1,038,477	100%
營業成本	482,816	64%	360,743	67%	485,494	63%	561,008	54%
營業毛利	267,546	36%	177,582	33%	287,667	37%	477,469	46%
營業費用	159,150	21%	126,879	24%	151,613	20%	200,726	19%
營業淨利	108,396	14%	50,703	9%	136,054	18%	276,743	27%
稅前淨利	116,991	16%	76,553	14%	141,451	18%	328,355	32%
稅後淨利	94,751	13%	70,772	13%	116,120	15%	247,299	24%
EPS	2.43		1.84		3.02		6.37	

免責聲明

- ◆ 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- ◆ 本公司未來實際產生之營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測市場及資訊有差異，其原因為競爭之各種因素，包括但不限於匯率波動、國際經濟狀況、匯率波動、國際經濟狀況、匯率波動等。
- ◆ 本簡報中所提供之資訊，係反映本公司截至目前為止對未來之看法，並未明示或暗示其內容之準確性、完整性或可靠性。對新或修正之資訊，本公司將另行公告。
- ◆ 未經本公司允許情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容作為商業用途。

UVAT

Vacuum Ecosystems

Thank you

友威科技股份有限公司
UVAT Technology Co., Ltd.

